

BOTAMENT® NextBoard

Płyta budowlana



BOTAMENT® NextBoard to lekka, wodoszczelna płyta budowlana o wszechstronnym zastosowaniu. Wykonana na jest na bazie rdzenia z polistyrenu ekstrudowanego XPS pochodzącego z recyklingu* pokrytego obustronnie specjalną zaprawą mineralną z wtopioną siatką wzmacniającą z włókna szklanego. Nadaje się do stosowania na wszystkich nośnych podłożach. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz w strefach cokołowych oraz na podbitki dachowe. Właściwości oraz parametry zostały potwierdzone Krajową Oceną Techniczną ICiMB-KOT-2020/0078.

Poprzednia nazwa produktu BotaGreen® BP.

* > 80% XPS w rdzeniu stanowi materiał pochodzący z recyklingu, zgodnie z deklaracją środowiskową EPD-BAC-20220231-CBA1-EN.

Właściwości

- ❖ rdzeń wykonany w 80% z recyklingu XPS
- ❖ szybka obróbka
- ❖ łatwe przycinanie
- ❖ stabilna i wodoodporna
- ❖ możliwość dowolnego kształtowania
- ❖ właściwości termoizolacyjne
- ❖ nie wymaga gruntowania pod płytki

Obszary zastosowania

- ❖ jako podłoże pod zaprawy klejowe i masy szpachlowe w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych, jak łazienki czy pomieszczenia wellness
- ❖ wyrównywanie powierzchni ściennych i podłogowych w nowym i starym budownictwie
- ❖ budowa ścianek działowych
- ❖ indywidualne kształtowanie blatów pod umywalki, zabudowy wanny, obudowy rur oraz innych konstrukcji
- ❖ na zewnątrz: podbitki dachowe, strefy cokołowe – wyrównanie podłoża pod okładziny z płytek, tynku dekoracyjnego oraz termoizolacja

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- ❖ suche i czyste
- ❖ nośne
- ❖ oczyszczone z tłuszczu, starych powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części

Ponadto należy zwrócić uwagę, aby:

- ❖ chłonne podłoża zagruntować D11
- ❖ podłoża niechłonne, drewniane, stare okładziny ceramiczne zagruntować MultiPrimer (nierozcieńczony)

Parametry techniczne

Baza materiałowa	polistyren ekstrudowany XPS o zamknięto-komórkowej strukturze, bez zawartości związków CFC wykonany z materiału pochodzącego z recyklingu
Przechowywanie	w suchym pomieszczeniu, bez bezpośredniego nasłonecznienia, płyty długości 260 cm zalecane składowanie w pozycji poziomej, płyty długości 120 cm w pionie i poziomie

Parametry techniczne polistyrenu ekstrudowanego

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła zgodnie z EN 12667	0,033 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 0,3 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 0,3 N/mm²
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej zgodnie z EN12086 (μ)	~ 150
Długotrwała absorpcja wody przez zanurzenie zgodnie z EN12087 (%)	≤ 1
Zakres temperatur	- 50 °C do + 75 °C
Euroklasa reakcji na ogień EN13501-1	F
Zawartość lotnych związków organicznych VOC	< 0,1 g/l
Stężenie formaldehydu Raport z badań LZF00-01295/26/R64NZF	niewykrywalny

Wymiary:

1200x600 mm grubość 4; 6; 10; 12,5; 20; 30; 40; 50 mm
2600x600 mm o grubość 10; 12,5; 20; 30; 40; 50 mm

BOTAMENT® NextBoard

Płyta budowlana

Obróbka

Przycinanie za pomocą nożyka, pilki ręcznej, wyrzynarki.

Ściany, podłoża mineralne (mur, beton, tynk)	Klejenie/mocowanie	Uwagi
Równe, nośne	Klejenie całościowe za pomocą zapraw klejowych Botament.	
Równe, ograniczona nośność	Klejenie całościowe za pomocą zapraw klejowych Botament + mocowanie za pomocą wkrętów (5 szt./m ²)	Końkowanie obu krawędzi płyty w odległości ≤ 65 cm
Nierówne nośne	Klejenie punktowe (tzw. na placki) za pomocą zapraw klejowych Botament. Płyty należy dobić za pomocą gumowego młotka + mocować za pomocą wkrętów 5 szt./m ²	Klejenie punktowe tzw. na placki + mocowanie za pomocą wkrętów. Na płycie należy oznaczyć miejsca tzw. placków, a następnie mocować tak, aby wkręt przechodził, przez plack z zaprawy klejowej
Ramy konstrukcyjne drewniane lub metalowe	Ułożyć płyty budowlane poziomo + przymocować wkrętami do drewna / śrubami do metalu (5 szt./m ²).	Grubość płyty: ≥ 10 mm Rozstaw osi ≤ 62,5 cm
Posadzki, podłoża mineralne (beton, jastrych)	Klejenie całościowe bez pustek powietrznych za pomocą zapraw klejowych Botament. Płyty powinny być ułożone z lekkim przesunięciem	Grubość płyty ≥ 10 mm, wyrównać podłoże
Podbitki dachowe	Mocowanie do konstrukcji drewnianych lub rusztów metalowych za pomocą wkrętów z talerzykami montażowymi	Grubość płyty: ≥ 10 mm rozstaw konstrukcji, rusztu w osiach ≤ 62,5 cm
Posadzki drewniane	Klejenie całościowe bez pustek powietrznych za pomocą zapraw klejowych Botament. Płyty powinny być ułożone z lekkim przesunięciem. Po związaniu zaprawy dodatkowo mocować kołkami do drewna wraz z talerzykami montażowymi 5 szt./m ²	Grubość płyty min. 10 mm /śruby wkręcić na min. 20 mm głębokości, wyrównać podłoże

Ważne wskazówki

Płyty budowlane NextBoard o grubości 4 i 6 mm nadają się tylko do przyklejania całościowego.

Na podłogach drewnianych wielkość płytki ceramicznej, która zostanie przyklejona na płytę budowlaną nie powinna być mniejsza niż 10 x 10 cm, a minimalna grubość powinna wynosić 7 mm.

W celu osiągnięcia optymalnych wyników zaleca się wykonanie próby w warunkach budowy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je dostosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-2609. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.pl

BOTAMENT® • ul. Prądyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.pl